

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年10月6日(06.10.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/210262 A1

(51) 国際特許分類:
B32B 27/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01) C09J 7/35 (2018.01)
H01L 21/02 (2006.01) B32B 7/06 (2019.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/013996

(22) 国際出願日: 2022年3月24日(24.03.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-061735 2021年3月31日(31.03.2021) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森谷 俊介 (MORIYA Shunsuke); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
奥野 貴久 (OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡IP特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

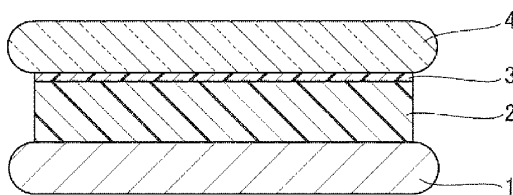
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: LAMINATE, RELEASE AGENT COMPOSITION, AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 積層体、剥離剤組成物及び加工された半導体基板の製造方法



(57) Abstract: This laminate comprises: a semiconductor substrate; a light-transmitting support substrate; and an adhesion layer and a release layer that are disposed between the semiconductor substrate and the support substrate. The release layer absorbs light having been emitted from the support substrate side, and then is used for releasing the semiconductor substrate and the support substrate from each other. The release layer is formed from a release agent composition. The release agent composition has a structure for absorbing the light, contributes to, by absorbing the light, an easy release of the semiconductor substrate and the support substrate from each other, and contains: a compound having at least one hydroxyl group; and an organosiloxane polymer.



WO 2022/210262 A1

(57) 要約：半導体基板と、光透過性の支持基板と、前記半導体基板と前記支持基板との間に設けられた、接着層と剥離層とを有し、前記支持基板側から照射された光を前記剥離層が吸収した後に前記半導体基板と前記支持基板とが剥がされることに用いられる積層体であって、前記剥離層が、剥離剤組成物から形成される層であり、前記剥離剤組成物が、前記光を吸収する構造であり、前記光を吸収することによって前記半導体基板と前記支持基板とが剥がされやすくなることに寄与し、かつ少なくとも一つのヒドロキシ基を有する化合物と、オルガノシロキサンポリマーとを含有する、積層体。